2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年11月6日

上場会社名　TOWA株式会社　　上場取引所　東
コード番号　6315　URL https://www.towajapan.co.jp
代表者　(役職名) 取締役社長執行役員　(氏名) 三浦　宗男
問合せ先責任者　(役職名) 取締役執行役員経営企画本部長　(氏名) 中西　和彦　TEL 075 - 692 - 0251

半期報告書提出予定日　2026年11月9日
配当支払開始予定日　―
決算補足説明資料作成の有無　：　有
決算説明会開催の有無　：　有　機関投資家・アナリスト向け

(百万円未満切捨て)

1. 2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績(2026年4月1日～2026年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期中間期	33,717	43.8	5,687	128.1	5,280	120.6	3,832	107.2
2026年3月期中間期	23,449	△14.4	2,493	△52.6	2,394	△54.2	1,849	△51.7

(注) 包括利益　2027年3月期中間期　7,642百万円　(95.3%)　2026年3月期中間期　3,912百万円　(162.6%)

	1株当たり中間純利益	潜在株式調整後1株当たり中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期中間期	51.08	―
2026年3月期中間期	24.66	―

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年3月期中間期	117,888	76,785	65.1
2026年3月期	106,267	70,611	66.4

(参考) 自己資本　2027年3月期中間期　76,785百万円　2026年3月期　70,611百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	―	0.00	―	20.00	20.00
2027年3月期	―	0.00			
2027年3月期(予想)			―	30.00	30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　有

配当予想の修正については、本日(2026年11月6日)公表いたしました「2027年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 2027年3月期の連結業績予想(2026年4月1日～2027年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	71,000	30.6	13,150	90.1	12,750	83.5	9,000	95.9	119.95

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

連結業績予想の修正については、本日(2026年11月6日)公表いたしました「2027年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 当中間期における連結範囲の重要な変更 ： 無

(2) 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2027年3月期中間期	75,167,951 株	2026年3月期	75,157,367 株
② 期末自己株式数	2027年3月期中間期	125,703 株	2026年3月期	129,348 株
③ 期中平均株式数（中間期）	2027年3月期中間期	75,033,327 株	2026年3月期中間期	75,013,101 株

（注） 期末自己株式数には、「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式が含まれております。また、「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

※ 第2四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料P．3「1．経営成績等の概況（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

2．当社は2026年11月6日に機関投資家・アナリスト向け説明会（ウェブ）を開催する予定です。決算説明会資料及び決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 …… 2
（１）当中間期の経営成績の概況…… 2
（２）当中間期の財政状態の概況 …… 3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 3
２．中間連結財務諸表及び主な注記 …… 4
（１）中間連結貸借対照表 …… 4
（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …… 6
中間連結損益計算書 …… 6
中間連結包括利益計算書 …… 7
（３）中間連結財務諸表に関する注記事項 …… 8
（継続企業の前提に関する注記） …… 8
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 8
（セグメント情報等の注記） …… 8

１．経営成績等の概況

（１）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間における世界経済は、総じて底堅く推移したものの、エネルギー価格や物価の動向に加え、各国の金融・通商政策や地政学リスクなどを背景に、先行き不透明な状況が続きました。半導体業界においては、生成AIやデータセンター向け需要を背景として、先端ロジック及びHBMをはじめとする高性能メモリが市場を牽引したほか、データセンター向けサーバーの電源管理用途など、その需要は周辺の半導体分野にも広がりを見せており、半導体メーカー各社による設備投資拡大の動きが継続しました。

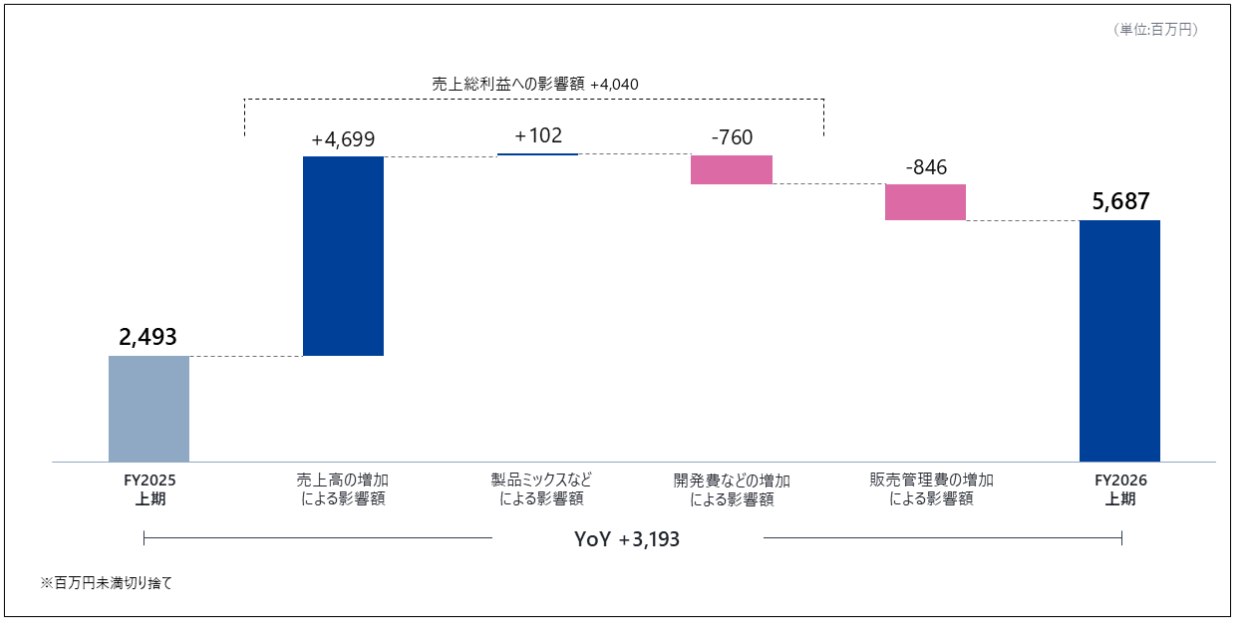
このような事業環境のもと、当社グループは、半導体メーカー各社の設備投資需要を着実に取り込んだ結果、前年同期比で増収増益を達成いたしました。また、売上高は中間連結会計期間として過去最高を更新いたしました。受注につきましても、幅広い半導体分野における旺盛な設備投資需要を背景に堅調に推移し、受注高は547億87百万円となり、中間連結会計期間として過去最高を更新いたしました。

当中間連結会計期間の経営成績は次のとおりであります。

売上高	337億17百万円（前年同期比102億67百万円、43.8%増）
営業利益	56億87百万円（前年同期比31億93百万円増、2.3倍）
経常利益	52億80百万円（前年同期比28億86百万円増、2.2倍）
親会社株主に帰属する中間純利益	38億32百万円（前年同期比19億83百万円増、2.1倍）

当中間連結会計期間の営業利益の主な増減要因（対前年同期）は次のとおりであります。

売上高の増加による影響額	46億99百万円増
製品ミックスなどによる影響額	１億２百万円増
開発費などの増加による影響額	７億60百万円減
販売管理費の増加による影響額	８億46百万円減



セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

［半導体製造装置事業］

半導体製造装置事業における経営成績は、データセンター向けサーバー需要を中心とした半導体設備投資の拡大を背景に、中国・韓国などアジア地域を中心に売上が増加したことから、売上高は315億１百万円（前年同期比99億16百万円、45.9％増）となりました。利益につきましては、売上高の増加により、営業利益54億１百万円（前年同期比30億50百万円増、2.3倍）となりました。

［メディカルデバイス事業］

メディカルデバイス事業における経営成績は、医療用の組立品の需要が堅調であったことから、売上高13億89百万円（前年同期比１億65百万円、13.5％増）、営業利益２億89百万円（前年同期比64百万円、28.8％増）となりました。

［レーザ加工装置事業］

レーザ加工装置事業における経営成績は、主力製品であるレーザトリマ装置の売上高が増加したことから、売上高は８億25百万円（前年同期比１億85百万円、29.0％増）となりました。一方、損益面では、増収により収益改善が進んだものの、固定費負担を吸収するには至らず、営業損失３百万円（前年同期は営業損失82百万円）となりました。

（２）当中間期の財政状態の概況

当中間連結会計期間末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ116億21百万円増加し、1,178億88百万円となりました。これは主に、現金及び預金が37億16百万円、棚卸資産が29億19百万円増加したことに加え、投資その他の資産のその他に含まれる投資有価証券が38億58百万円増加したことによるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ54億47百万円増加し、411億２百万円となりました。これは主に、運転資金等に係る短期借入金が25億円、流動負債のその他に含まれる前受金が26億３百万円増加したことによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ61億74百万円増加し、767億85百万円となりました。これは主に、保有有価証券の評価額上昇に伴いその他有価証券評価差額金が26億45百万円増加したことに加え、利益剰余金が23億30百万円、為替換算調整勘定が11億83百万円増加したことによるものであります。

その結果、自己資本比率は65.1％となり、前連結会計年度末の66.4％から1.3ポイント低下いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体市場においては、生成AIやデータセンター向け需要の拡大を背景に、先端ロジックやHBMをはじめとする高性能メモリへの投資が活発に推移しています。加えて、アナログ半導体やパワー半導体など設備投資の動きは幅広い分野に広がっており、半導体メーカーによる設備投資は当初の想定を上回る水準となっています。こうした市場環境を背景に、当社の半導体製造装置に対する需要も想定を上回って推移しています。

これらの足元の市場環境及び業績動向等を踏まえ、通期の連結業績予想を上方修正いたしました。売上高につきましては当初予想から過去最高を見込んでおりましたが、今回の上方修正により、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益についても、過去最高を更新する見込みです。

詳細につきましては、本日（2026年11月６日）公表いたしました「2027年３月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,431,711	32,148,312
受取手形及び売掛金	16,163,686	17,471,041
電子記録債権	201,287	141,589
リース債権及びリース投資資産	12,955	9,657
商品及び製品	5,681,054	6,204,656
仕掛品	11,830,117	14,430,375
原材料及び貯蔵品	2,279,450	2,075,010
その他	2,596,216	1,944,883
貸倒引当金	△28,502	△9,634
流動資産合計	67,167,977	74,415,892
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	24,872,224	25,068,230
減価償却累計額	△14,808,340	△15,222,452
建物及び構築物（純額）	10,063,884	9,845,777
機械装置及び運搬具	20,502,224	21,116,990
減価償却累計額	△14,149,039	△14,893,119
機械装置及び運搬具（純額）	6,353,184	6,223,870
土地	6,635,889	6,882,870
リース資産	1,958,276	1,975,451
減価償却累計額	△716,646	△783,028
リース資産（純額）	1,241,629	1,192,422
建設仮勘定	766,950	755,996
その他	5,893,780	6,026,541
減価償却累計額	△4,760,340	△4,941,510
その他（純額）	1,133,439	1,085,030
有形固定資産合計	26,194,978	25,985,968
無形固定資産	2,241,001	2,557,105
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	937,507	968,255
その他	9,726,307	13,961,711
投資その他の資産合計	10,663,815	14,929,967
固定資産合計	39,099,795	43,473,042
資産合計	106,267,772	117,888,934

（単位：千円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,432,148	6,190,844
電子記録債務	25,653	50,193
短期借入金	11,500,000	14,000,000
１年内返済予定の長期借入金	2,120,000	1,780,000
未払法人税等	1,079,860	1,223,062
製品保証引当金	299,462	326,092
賞与引当金	1,330,104	1,610,468
役員賞与引当金	143,716	49,733
その他	5,628,008	7,164,659
流動負債合計	27,558,954	32,395,054
固定負債		
長期借入金	4,000,000	3,280,000
退職給付に係る負債	1,081,681	1,083,630
株式給付引当金	133,620	157,078
その他	2,881,680	4,187,175
固定負債合計	8,096,982	8,707,885
負債合計	35,655,936	41,102,939
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,985,585	9,000,720
資本剰余金	480,895	496,030
利益剰余金	48,570,745	50,901,408
自己株式	△110,772	△107,001
株主資本合計	57,926,454	60,291,157
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,948,622	7,594,251
為替換算調整勘定	7,620,024	8,803,604
退職給付に係る調整累計額	116,733	96,980
その他の包括利益累計額合計	12,685,381	16,494,836
純資産合計	70,611,835	76,785,994
負債純資産合計	106,267,772	117,888,934

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

（中間連結損益計算書）

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
売上高	23,449,896	33,717,759
売上原価	15,501,756	21,728,970
売上総利益	7,948,140	11,988,788
販売費及び一般管理費	5,454,562	6,301,253
営業利益	2,493,577	5,687,535
営業外収益		
受取利息	76,220	127,658
受取配当金	70,115	85,127
スクラップ売却収入	13,486	121,765
雑収入	145,473	212,616
営業外収益合計	305,295	547,166
営業外費用		
支払利息	62,563	157,524
為替差損	311,134	770,674
雑損失	31,069	26,031
営業外費用合計	404,767	954,229
経常利益	2,394,105	5,280,472
特別利益		
固定資産売却益	458	1,049
受取損害賠償金	87,588	－
特別利益合計	88,047	1,049
特別損失		
固定資産売却損	2,210	31
固定資産除却損	1,121	2,616
特別損失合計	3,332	2,648
税金等調整前中間純利益	2,478,820	5,278,873
法人税等	628,982	1,445,939
中間純利益	1,849,838	3,832,934
親会社株主に帰属する中間純利益	1,849,838	3,832,934

（中間連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
中間純利益	1,849,838	3,832,934
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	934,361	2,645,628
為替換算調整勘定	1,148,581	1,183,580
退職給付に係る調整額	△20,388	△19,753
その他の包括利益合計	2,062,554	3,809,455
中間包括利益	3,912,392	7,642,389
（内訳）		
親会社株主に係る中間包括利益	3,912,392	7,642,389

（３）中間連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自2025年４月１日　至2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	21,585,649	1,224,106	640,139	23,449,896
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－
計	21,585,649	1,224,106	640,139	23,449,896
セグメント利益又は損失（△）	2,350,817	225,010	△82,249	2,493,577

（注）セグメント利益又は損失の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。

Ⅱ　当中間連結会計期間（自2026年４月１日　至2026年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	31,501,956	1,389,897	825,906	33,717,759
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－
計	31,501,956	1,389,897	825,906	33,717,759
セグメント利益又は損失（△）	5,401,109	289,761	△3,335	5,687,535

（注）セグメント利益又は損失の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。